



ALADI/AAP.CE/18.90
18 de outubro de 2011

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI E URUGUAI

Nonagésimo Protocolo Adicional

Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),

TENDO EM VISTA o Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao ACE-18 e a Resolução GMC Nº 43/03,

CONVÊM EM:

Artigo 1º - Incorporar ao Acordo de Complementação Econômica Nº 18 a Diretriz Nº 07/11 da Comissão de Comércio do MERCOSUL relativa a "Adequação de Requisitos Específicos de Origem", que consta como anexo e integra o presente Protocolo.

Artigo 2º - O presente Protocolo entrará em vigor trinta dias após a notificação da Secretaria-Geral da ALADI aos países signatários de que recebeu a comunicação da Secretaria do MERCOSUL informando a incorporação da norma MERCOSUL e de seu correspondente Protocolo Adicional aos ordenamentos jurídicos dos quatro Estados Partes do MERCOSUL.

A Secretaria-Geral da ALADI deverá efetuar tal notificação, na medida do possível, no mesmo dia em que receba a comunicação da Secretaria do MERCOSUL.

Artigo 3º - Uma vez em vigor, o presente Protocolo modificará o Anexo ao Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional ao ACE Nº 18 - Anexo I da Diretriz CCM Nº 10/07 -, e o Anexo ao Septuagésimo Sétimo Protocolo Adicional ao ACE Nº 18 - Apêndice I da Decisão CMC Nº 01/09; e revogará o Octogésimo Primeiro e o Octogésimo Segundo Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica Nº 18.

A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos dos países signatários e à Secretaria do MERCOSUL.

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevideu, aos doze dias do mês de outubro de dois mil e onze, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.) Pelo Governo da República Argentina: Daniel Raimondi; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Otávio Brandelli; Pelo Governo da República do Paraguai: Alejandro Hamed Franco; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

SECRETARIA DO MERCOSUL
RESOLUÇÃO GMC Nº 26/01 – ARTIGO 10
FÉ DE ERRATAS – ORIGINAL – 11/08/11

Agustín Colombo Sierra
Diretor

MERCOSUL/CCM/DIR. Nº 07/11

ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEM

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, as Decisões Nº 08/03 e 01/09 do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções Nº 29/10, 30/10 e 47/10 do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes Nº 10/07, 21/09 e 22/09 da Comissão de Comércio do MERCOSUL.

CONSIDERANDO:

Que o Regime de Origem MERCOSUL faculta à Comissão de Comércio do MERCOSUL modificar tal Regime por meio de Diretrizes.

Que é necessário adequar os requisitos específicos de origem do Regime de Origem do MERCOSUL às modificações na Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

Que é necessário atualizar os requisitos específicos de origem do Regime de Origem do MERCOSUL para os Bens de Informática e Telecomunicação.

Que conforme estabelecido no Artigo 2º da Decisão CMC Nº 08/03, “enquanto uma norma que revogue uma ou mais normas anteriores não entre em vigência de acordo com o Artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto, continuarão vigentes as normas anteriores que pretendam ser revogadas, sempre que tiverem sido incorporadas pelos quatro Estados Partes”.

Que em função disso, é conveniente adotar medidas transitórias com vistas a agilizar a entrada em vigência dos requisitos de origem para facilitar a operação comercial entre os Estados Partes.

A COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL APROVA A SEGUINTE DIRETRIZ:

Art. 1º - Modifica-se o Apêndice I da Decisão CMC Nº 01/09 conforme consta nos Anexos I e II que fazem parte da presente Diretriz.

Art. 2º - Até a Decisão CMC Nº 01/09 entrar em vigência, as modificações estabelecidas no Art. 1º aplicar-se-ão ao Anexo I da Diretriz CCM Nº 10/07, no que couber.

Art. 3º - Revogam-se as Diretrizes CCM Nº 21/09 e Nº 22/09.

Art. 4º - Solicita-se aos Estados Partes que instruem suas respectivas Representações junto à Associação Latino-americana de Integração (ALADI) a protocolizar a presente Diretriz no marco do Acordo de Complementação Econômica Nº 18, nos termos estabelecidos na Resolução GMC Nº 43/03.

Art. 5º - Esta Diretriz deverá ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados partes antes de 31/X/2011.

CXX CCM – Montevideu, 19/V/11

ANEXO I

a) Incorporar à lista:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
2102.10.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
2102.10.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.11.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.12.50	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.13.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.13.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.13.50	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.14.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.92.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.93.40	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.94.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.94.20	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.94.30	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.94.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
7304.51.11	Deverão ser produzidos a partir de produtos incluídos na posição 7206 ou 7207 ou 7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.
7304.51.19	Deverão ser produzidos a partir de produtos incluídos na posição 7206 ou 7207 ou 7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.
9006.10.10	60% de valor agregado regional.
9006.10.90	60% de valor agregado regional.

b) Eliminar da lista:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
2102.10.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.91.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
5603.94.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
7304.51.10	Deverão ser produzidos a partir de produtos incluídos na posição 7206 ou 7207 ou 7218 ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.
9006.10.00	60% de valor agregado regional.

ANEXO II

a) Substituir na lista

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8443.32.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.32.22	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.32.23	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
	de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	
8443.32.29	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.32.35	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.32.39	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
	estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	
8443.32.51	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.32.59	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8470.50.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
	um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	
8470.50.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.30.12	MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.30.19	MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
	<p>todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>	<p>impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>
8471.30.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecida nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>
8471.41.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.50.10	<p>UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO DE PEQUENA CAPACIDADE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória e as seguintes interfaces: em série, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado e de vídeo, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporem no mesmo corpo o gabinete placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter uma montagem e soldagem de todos os componentes. B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Não descaracteriza o cumprimento do Regime de Origem definido, a inclusão no mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação. Nas unidades digitais de processamento do tipo "diskless", destinadas à interconexão em redes locais, a montagem da placa que implementa a interface de rede local poderá substituir a montagem das placas que implementam as interfaces em série, paralela e de unidades de discos magnéticos;</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>
8471.50.20	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa optar pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.50.30	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa optar pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>
8471.50.40	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MUITO GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem pelo menos 2 (duas) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface; d) suporte e diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicação, ou alternativamente, a montagem de pelo menos 3 (três) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções; B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos. Quando a empresa optar pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como</p>	<p>I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.</p>

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
	controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.	
8471.50.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.52	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.60.53	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.59	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.61	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.60.62	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.80	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.60.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.70.12	DISCOS RÍGIDOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B"; D. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes, por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B"; e E. Para a produção de discos magnéticos rígidos com capacidade de armazenamento superior a 1 (um) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) não formatado, poderá ser feita a opção entre cumprir com o disposto nos itens "A" ou "B", sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item "A" deverão ser soldados e montados todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem pelo menos duas das seguintes funções: a) comunicação com a unidade controladora de disco; b) posicionamento dos conjuntos de leitura e gravação; c) ou leitura e gravação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.70.19	DISCOS RÍGIDOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B"; D. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes, por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B", e E. Para a produção de discos magnéticos rígidos com capacidade de armazenamento superior a 1 (um) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) não formatado, poderá ser feita a opção entre cumprir com o disposto nos itens "A" ou "B", sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item "A" deverão ser soldados e montados todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem pelo menos duas das seguintes funções: a) comunicação com a unidade controladora de disco; b) posicionamento dos conjuntos de leitura e gravação; c) ou leitura e gravação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.70.39	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.70.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.80.00	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.90.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.90.12	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.90.13	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8471.90.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8471.90.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8472.90.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8472.90.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8472.90.29	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8472.90.59	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.29.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.30.41	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.30.42	PLACAS (MÓDULOS DE MEMÓRIA) COM UMA SUPERFÍCIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2. REQUISITO: Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha; C. Teste (ensaio) elétrico; D. Marcação (identificação) do componente (memória); eE. Montagem e soldagem dos componentes semicondutores (memória) no circuito impresso.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8473.30.49	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.40.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.50.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8473.50.50	PLACAS (MÓDULOS DE MEMÓRIA) COM UMA SUPERFÍCIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2. REQUISITO: Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha; C. Teste (ensaio) elétrico; D. Marcação (identificação) do componente (memória); eE. Montagem e soldagem dos componentes semicondutores (memória) no circuito impresso.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8511.80.30	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.11	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.12.12	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.13	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo:A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.12.22	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.23	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.31	Cumprir com o seguinte processo produtivo:A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.12.33	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.39	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.41	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.12.49	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.12.90	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.18.20	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.11	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.19	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.20	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
		sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.43	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.49	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.91	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.61.92	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.61.99	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.11	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.13	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.14	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.19	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.21	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.22	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; II.- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.23	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; II.- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.24	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; II.- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.31	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.32	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.33	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.41	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.48	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.51	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.53	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.55	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.61	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.62	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.64	Cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.65	Cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.71	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.72	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.79	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
		sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.91	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.93	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.94	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes em no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; II.- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8517.62.95	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.96	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.70.10	Circuitos impressos montados com componentes elétricos ou eletrônicos. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8523.52.00	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar ou processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8523.59.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.50.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
		produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.50.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.60.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8525.60.90	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8528.51.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8528.51.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8528.61.00	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8529.90.12	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8531.20.00	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8537.10.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
8537.10.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8537.10.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.12	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.14	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
		sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.15	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.39	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8543.70.91	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; eD - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9030.33.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.33.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.39.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecida nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9030.40.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.40.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.40.30	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9030.40.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.82.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.82.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9030.89.40	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.89.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9030.90.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9031.80.40	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9032.89.22	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.23	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.24	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9032.89.25	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.29	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.81	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9032.89.82	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.83	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
9032.89.89	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

NCM 2007	ONDE DIZ:	DEVE DIZER:
	REQUISITO DE ORIGEM	REQUISITO DE ORIGEM
9032.90.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. : Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

b) incorporar à lista

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
8443.31.11	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal); II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.12	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.13	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.14	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.15	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.16	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.19	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.91	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8443.31.99	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.-

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.52	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.54	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.59	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.77	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.78	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.62.92	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8517.69.00	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8528.71.11	I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente a função de Processamento central (placa principal) ; II- Integração da placa de circuito impresso montada de acordo com o inciso I, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das demais partes elétricas, mecânicas e sub-conjuntos na formatação do produto final, e ; III.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.
8538.90.10	I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; II.- Configuração final do produto, instalação de software (quando for o caso) e testes de funcionamento.

c) eliminar da lista

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
8443.31.00	60% de valor agregado regional.
8443.32.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do Regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fontes de alimentação.
8443.32.12	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do Regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fontes de alimentação.
8443.32.13	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do Regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fontes de alimentação.
8443.32.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do Regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fontes de alimentação.
8443.99.11	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.
8443.99.13	Mudança de posição e que cumpra com o seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8443.99.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8443.99.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8443.99.24	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do Regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fontes de alimentação.
8443.99.31	60% de valor agregado regional.
8443.99.39	60% de valor agregado regional.
8473.29.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.30.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.30.19	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.30.31	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas,

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.30.39	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.30.99	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.50.32	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.50.39	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8473.50.90	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas,

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8517.70.92	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.70.99	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8518.10.10	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8518.29.10	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8528.41.10	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8528.41.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8529.90.19	Mudança de posição e comprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8540.50.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8541.10.22	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.92	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.99	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.29.20	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.30.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.30.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.16	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.22	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.26	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.31	CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico referente às etapas de divisão, texturização e metalização; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e D. Marcação (identificação).
8541.40.32	CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico referente às etapas de divisão, texturização e metalização; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e D. Marcação (identificação).
8541.50.20	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.91	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.33.90	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.39.39	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B.

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.39.99	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8543.70.92	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.99	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A – Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B – Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8544.70.10	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; eG. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
8544.70.30	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; eG. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
8544.70.90	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; eG. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
9001.10.11	FIBRAS ÓPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico que resulte na obtenção da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Será admitida a realização da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; eF. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios).
9001.10.19	FIBRAS ÓPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico que resulte na obtenção da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Será admitida a realização da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; eF. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios).
9001.10.20	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; eG. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEM
	mesmas.
9026.10.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
9028.30.31	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.